

杭州士兰微电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募集资金投资项目：2018 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目”、“8 英寸芯片生产线二期项目”；2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“8 英寸集成电路芯片生产线二期项目”、“偿还银行贷款”。

● 结项后节余募集资金安排：本次结项后，公司 2018 年和 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目全部实施完毕，公司拟将上述募投项目节余募集资金共计 655.48 万元（实际金额以资金转出当日银行结息后具体金额为准）用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、股东大会审议，亦无须保荐机构/独立财务顾问、监事会发表意见。

一、募集资金概述

（一）2018 年向特定对象发行募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2005 号），公司向 6 名特定对象非公开发行人民币普通股 64,893,614 股，每股发行价为人民币 11.28 元，募集资金总额为人民币 731,999,965.92 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 26,405,660.37 元，实际募集资金净额为人民币 705,594,305.55 元。该项募集资金已于 2018 年 1 月 3 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2018〕1 号《验资报告》。

2、募集资金投资项目基本情况

根据公司于 2017 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第六次会议和 2017 年 4 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、公司 2018 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，以及公司 2019 年 11 月 8 日召开的第七届董事会第五次会议和 2019 年 11 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》，公司本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额
1	年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	70,559.43	30,559.43
2	8 英寸芯片生产线二期项目	150,840.00	30,000.00
3	特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	33,485.00	10,000.00
合计		254,884.43	70,559.43

3、部分募集资金投资项目前期结项情况

根据公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目“特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目”予以结项，并将节余募集资金（含结息）212.83 万元转入一般账户用于永久补充流动资金。

（二）2021 年向特定对象发行募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2533 号），公司非公开发行人民币普通股 21,660,231 股，募集配套资金总额为人民币 1,121,999,965.80 元，扣除各项发行费用人民币 30,012,264.15 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 1,091,987,701.65 元。该项募集资金已于 2021 年 9 月 17 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2021〕532 号《验资报告》。

2、募集资金投资项目基本情况

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》，公司本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	承诺募集资金投资总额
1	8英寸集成电路芯片生产线二期项目	150,840.00	53,098.77
2	偿还银行贷款	-	56,100.00
合计			109,198.77

二、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

公司本次结项的募投项目为2018年向特定对象发行募投项目之“年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目”、“8吋芯片生产线二期项目”和2021年向特定对象发行募投项目之“8英寸集成电路芯片生产线二期项目”、“偿还银行贷款”。截至目前，上述建设项目已基本建设完成并达到可使用状态、“偿还银行贷款”已使用完毕，公司将对上述募投项目予以结项。

截至2024年10月31日，上述募投项目的募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额(A)	累计投入募集资金金额(B)	利息收益净额(C)(注)	募集资金结余金额(D=A+C-B)
2018年向特定对象发行				
年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目	30,559.43	31,219.44	1,315.44	655.43
8吋芯片生产线二期项目	30,000.00	30,236.17	236.17	0.00
合计	60,559.43	61,455.61	1,551.61	655.43
2021年向特定对象发行				
8英寸集成电路芯片生产线二期项目	53,098.77	53,543.72	445.00	0.05
偿还银行贷款	56,100.00	56,517.27	417.27	0.00
合计	109,198.77	110,060.99	862.27	0.05

注：利息收益净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额。

三、节余募集资金的原因及后续安排

(一) 募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则,审慎地使用募集资金,通过加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化,合理降低项目相关成本和费用,形成了募集资金节余。

(二) 节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计 655.48 万元(实际金额以资金转出当日银行结息后具体金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。节余募集资金全部转出后,公司将办理上述项目的募集资金专户注销手续,公司及相关子公司(项目实施主体)与保荐机构/独立财务顾问、开户银行签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》随之终止。

四、相关审议程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包含利息收入)低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的,可以免于履行审议程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。鉴于公司 2018 年和 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部完成且节余募集资金分别低于募集资金净额的 5%,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、股东大会审议,亦无须保荐机构/独立财务顾问、监事会发表意见。

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日